

21-1ポリマーフロンティア21(オンライン開催) 「高分子」と「熱」

主催：高分子学会 行事委員会

日時：2021年4月27日(火)10:20～17:00

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を受け、感染拡大防止を最優先に考えた結果、Web開催と致します。ご了承下さい。

1. 新たな分子設計と改質手法に基づく熱硬化性樹脂の高性能化
(横浜国立大学) 大山 俊幸
2. 機能性高分子と新規熱硬化システム
(共栄社化学) 森脇 佑也
3. 韌性に優れた高耐熱ビスマレイミド樹脂の材料設計と応用
(大阪産業技術研究所) 大塚 恵子
4. 耐熱半芳香族ポリアミドの分子設計と開発動向
(クラレ) 關口 健治
5. 高分子の熱伝導とマテリアルズインフォマティクス
(東京工業大学) 森川 淳子
6. 超高速DSCを用いたアプリケーション事例の紹介
(メトラー・トレド) 鈴木 秀一

「高分子」と「熱」に関する材料開発と分析手法に関する最新動向を、それらの研究に携わる企業やアカデミアの研究者より紹介いただきます。奮ってご参加下さい。

定員 100名

参加費 ①企業22,000円 ②大学・官公庁11,000円 ③学生1,100円

④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員3,300円

※参加申込締切 4月20日(火)正午

詳細・お申込み：<https://member.spsj.or.jp/event/>

